

EPP

ELEKTRONIK PRODUKTION & PRÜFTECHNIK

7/8

AUGUST 2012



Jörg Friedrich, Leesy's:

„Wir benötigen eine eigene Identität.“



Baugruppenfertigung

**Produktionsoptimierung
durch Software und
Touch-Screen-Monitore**

Test & QS

**Testsysteme im Einsatz –
Qualität als Anspruch**

Hoher Durchsatz bei verbesserter Qualität

Löt- und Entlötstationen für höchste Ansprüche

Die i-CON Vario 4 Mehrkanal Löt- und Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an professionelles Löten und Entlöten gerecht. Das brandneue Flaggschiff der Ersä i-CON-Familie stellt dem Anwender vier Lötwerkzeuge für anspruchsvolle Lötarbeiten zur Verfügung: Flexibles Löten und Entlöten bei kontaktloser Energieübertragung mit dem neuen, ergonomischen Heißluftkolben i-Tool AIR S (200W), effizientes Einlöten mit dem 150W-starken i-Tool, präzises Ent-

„i-Op Bedienung“ und übersichtlichen Displays gebündelt. Die Station bietet darüber hinaus Schnittstellen für Ersä Lötrauchabsaugungen oder Infrarot-Vorheizungen sowie einen USB-Anschluss. Über eine microSD Speicherkarte kann die Station schnell und sicher konfiguriert werden und ist damit für alle Einsatzbereiche in der professionellen Elektronikfertigung bestens gerüstet. Die Station eignet sich auch für den Einsatz in ESD-Schutzzonen. Die i-CON Vario 2 stellt dem

übersichtliche Bedienbarkeit. Schnittstellen zu Lötrauchabsaugungen und Vorheizplatten sind ebenfalls vorhanden. Auch die i-CON Vario 2 lässt sich einfach und sicher über microSD Speicherkarte konfigurieren.

Ergonomisch handlich, stark in der Leistung! So kann der i-tool AIR S treffend beschrieben werden. Das schlanke und leichte Handstück trägt eine 200W leistende Heizkartusche und erlaubt so ermüdungsarmes Arbeiten an vielfältigen SMD Komponenten. Die Heißluftmenge kann einfach direkt am Handstück eingestellt werden; die jeweilige Luftmenge von 2 bis 20l/min ist gut sichtbar am Display einer i-CON Vario 2 oder 4 ablesbar. Auch zum Einlöten kleinster Chip Widerstände ist die Luftmenge exakt dosierbar. Für die optimale Erwärmung der Bauteile können verschiedene Düsen eingesetzt

werden. Ein Bewegungssensor aktiviert den i-Tool AIR S bei Bewegung aus der Ablage, mit einem IR-Sensor im Handstück kann er tastelos ein- und ausgeschaltet werden. Die Entlötpinzette Chip Tool VarioO zeichnet sich durch starke Leistung (2 x 40W) sowie einen sehr kompakten Aufbau aus. Sie ist damit bestens geeignet, feinste Lötarbeiten an sehr kleinen SMD-Bauteilen vorzunehmen. Die steckbaren Heizelement-Paare können am Griffstück exakt zueinander ausgerichtet werden und sind jederzeit schnell zu wechseln. Ein Umschaltelement erlaubt den Wechsel vom selbstschließenden zum selbstöffnenden Betrieb dieses Präzisionswerkzeugs. Der Chip Tool Vario verfügt wie der i-Tool und der i-Tool AIR über einen Bewegungssensor zur Aktivierung aus dem Standby-Betrieb.

www.ersa.de



Ersä i-CON Vario 4 stellt dem Anwender vier Lötwerkzeuge für anspruchsvolle Lötarbeiten zur Verfügung

löten feinsten SMD Elemente mit der neuen Entlötpinzette Chip Tool Vario (80W), und Entlöten bedrahteter Bauelemente mit dem bewährten X-Tool (120W). Alternativ ist der Anschluss weiterer Lötwerkzeuge des Unternehmens möglich. Sämtliche Funktionen, inklusive Luft- und Vakuumerzeugung, sind in einer zentralen Versorgungseinheit mit der gewohnt einfachen

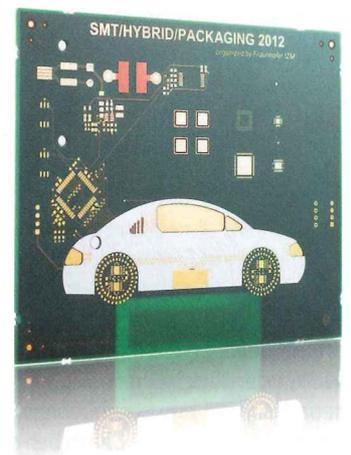
Anwender zwei gleichzeitig nutzbare Lötwerkzeuge zur Verfügung. Parallel zu dem neuen Heißluftkolben i-Tool AIR S kann mit dem i-Tool ein weiteres Lötwerkzeug zum klassischen Einlöten oder die neue Entlötpinzette Chip Tool Vario betrieben werden. Alternativ nutzbar sind weitere Ersä Lötwerkzeuge. Die kompakte, ESD sichere Versorgungseinheit bietet einfache und



Sicheres Entlöten feinsten SMD Elemente mit der Entlötpinzette Chip Tool Vario

Innovative Lösungen für Leistungselektronik

Schweizer Electronic bietet ein umfangreiches Spektrum an Leiterplatten-Lösungen an, mit der die Herausforderungen der Leistungselektronik nach immer mehr Strom und entsprechender Wärmeabführung realisierbar werden. Darüber hinaus bieten diese Lösungen vielfach auch die Möglichkeit, bisher verwendete Materialien wie Keramik und Stanzgitter kostengünstiger zu ersetzen. Die Highlights waren Bestandteile aus dem Innovationsbaukasten des Unternehmens. Im Bereich der Leistungselektronik wurde das Inlay Board vorgestellt, welches bis zu 1.200 Ampere führt. Ein Smart p² Pack für einen 40KW Elektromotor mit in die Leiterplatte integrierten IGBTs und Dioden veranschaulichte die Leistungsfähigkeit im Bereich (Power) Embedding. Stellvertretend für Systemkosten-Reduktion wurde eine FR4 Flex 3D Leiterplatte für ein TelemetrieModul vorgestellt. Dieses Modul ist in einer Fahrzeugfelge eingebaut und befindet sich bereits im Einsatz in



einem Elektro-Formelfahrzeug des KA-Racing-Teams, mit dem das Unternehmen eng kooperiert. Seine Kompetenz im Bereich von Premium-Leiterplatten demonstrierte das Unternehmen auch auf der SMT Hybrid Packaging in Nürnberg. Als Kooperationspartner des Gemeinschaftsstands des Fraunhofer IZM stellte man Leiterplatten für die Fertigungslinie „Future Packaging“ zur Verfügung.

www.mehrsLeiterplatten.de